エレクトロニクス

メタライゼーション

デスミア

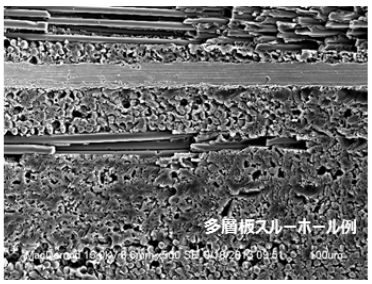
デスミア処理（デスミヤ処理）は、スルーホール内の内層銅、ブラインドビアホール底面銅からスミアを除去し、めっき析出性、めっき密着性の良い樹脂表面に整える工程です。

スルーホール、ブラインドビアホールのめっき信頼性に不可欠なプロセスです。

マクダーミッド・エンソンは、近年の高機能樹脂など様々なタイプの樹脂に適用できる様、複数の種類をラインアップしています。

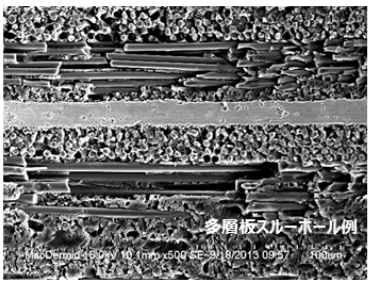
ディップ処理、コンベア処理両方に対応が可能です。

ホールコンディショニング

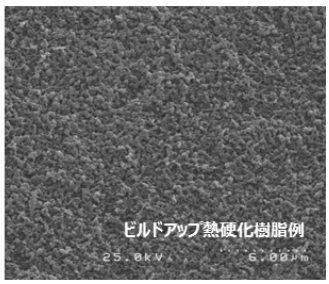


MacuDizer9204
非水系、強力、ライフ長、ディップ処理用

MacuDizer9204JH
非水系、強力、ライフ長、コンベア処理用



M-Treat HZ
水系、強力、ライフ長



M-Treat AQ
水系、マイルド、低コスト

過マンガン酸エッチング　MacuDizer9275 粉体　DS-224 液体

還元　MacuDizer9279